

表 2 含有禁止物質の管理基準

- (注) ①用途・使用例は全てを網羅していないため、不明な点は発行元に確認のこと。
 ②管理レベルにおいて、除外用途を示していない物質は、“適用除外用途なし”となる。
 ③各物質群の詳細については表 6 を参照のこと。なお、オゾン層破壊物質に関しては表 7 を参照。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
1	ポリ塩化ビフェニル類 (PCB 類)	禁止	絶縁油、潤滑油、電気絶縁媒体、溶剤、電解液	—	即時
		除外	副生成物として含まれる場合	50ppm	—
2	ポリ塩化ターフェニル類 (PCT 類)	禁止	絶縁油、潤滑油、電気絶縁媒体、溶剤、電解液	—	即時
3	ポリ塩化ナフタレン (塩素数：1 以上)	禁止	潤滑油、塗料、樹脂安定剤、電気絶縁媒体、難燃剤	—	即時
4	ポリ臭化ビフェニル類 (PBB 類)	禁止	難燃剤	1000ppm	即時
5	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE 類)	禁止	難燃剤	RoHS 対象製品： 1000ppm RoHS 対象外製品： テトラ-、ペンタ-、ヘキサ-、 ヘプタ-、デカ BDE の合計で 500ppm ただしデカ BDE は閾 値指定なし	即時
6	短鎖型塩化パラフィン (炭素鎖長：10-13)	禁止	塩ビ可塑剤、難燃剤	1000ppm	即時
7	アスベスト類	禁止	ブレーキライニング・パッド、絶縁体、充填剤、摩擦材、 電気絶縁材、充填ファイバー、顔料・塗料、タルク、断熱材	—	即時
8	オゾン層破壊物質 [※1]	禁止	冷媒、発泡剤、消火剤、洗浄剤	—	即時
		除外	副生成物として含まれる場合	—	—
9	カドミウム 及びその化合物	禁止	・包装材	表-3	即時
			・携帯型電池、蓄電池	20ppm	
			・塗料、インキ ・樹脂（ゴムを含む）材料中の顔料、染料、安定剤等の添加剤 ・電気カドミウムめっき処理及びカドミウムコート処理された材料及び部品 ・カドミウムを含む光沢剤を使用した無電解ニッケルめっき部品 ・ガラス及びガラス塗料の顔料、染料 ・カドミウムを含む銀ロウ材料 ・亜鉛及び亜鉛合金、亜鉛化合物などの材料及び部品（快削黄銅棒、ゴムベルト等） ・DC モーター、スイッチ、リレー、ブレーカ等の電気接点 ・温度ヒューズの可溶体 ・蛍光灯（小型蛍光灯、直管蛍光灯） ・ニッケル/カドミウム電池 ・蛍光表示装置に含有される蛍光体	100ppm	
10	六価クロム 及びその化合物	禁止	・皮膚と接触する革製品、革パーツを含む製品	3ppm (革の総乾燥重量において)	即時
			・包装材 ・塗料、インキ ・電気亜鉛めっき後クロメート処理された材料及び部品（一般機械部品、電装購入品及び電源装置等に使用される板金、ねじ、軸物、ベアリング等） ・クロメート化成処理（塗装前処理）されたアルミ、銅合金、亜鉛合金等の材料及び部品	表-3 1000ppm	即時

※1. オゾン層破壊物質は、製造工程での使用も禁止する。（第 5 参照）

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
11	鉛及びその化合物	禁止	・包装材	表-3	即時
			・ポリ塩化ビニル電線被覆中の鉛	300ppm [※2]	
			・塗料、インキ ・樹脂（ゴムを含む）材料中の顔料、染料、安定剤等の添加剤 ・鉛合金めっき処理された材料及び部品（すずめっきピアノ線等） ・潤滑剤としての鉛を含む部品（ドライベアリング等） ・鉛を含有する各種合金（但し、除外対象の合金は除く） ・はんだ材料（Pb=85%未満のはんだ） ・はんだ付けされた部品、ユニット（プリント基板、電源装置、モータ、クラッチ、センサー等） ・サーバー、ストレージ（HDD）中の鉛 ・FFC コネクタ接点部	1000ppm	
		除外	・ガラス蛍光管であって鉛含有量が、0.2wt%を超えないもの	二	二
			・機械加工目的のために合金成分として鋼材中に含まれる0.35wt%までの鉛、ホットディップ溶融亜鉛めっき鋼中に0.2wt%まで含まれる鉛		
			・鉛含有アルミニウムスクラップのリサイクルに由来するアルミニウムに合金元素として含まれる0.4wt%までの鉛		
			・機械加工用とのアルミニウムに合金元素として含まれる0.4wt%以下の鉛		
			・銅合金に含まれる鉛（4.0wt%以下）		
			・高融点はんだに含まれる鉛（鉛含有量が重量で85%以上の鉛ベースの合金）		
			・コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中又は、セラミック中に鉛を含む電気電子部品（例：圧電素子）、もしくはガラス又は、セラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品		
			・定格電圧がAC125V又は、DC250V又は、それ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛		
・定格電圧がAC125V又は、DC250V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛 但し、2013年1月1日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツに限る					
・光学用途に使用される白色ガラス中に含まれる鉛					
・マイクロプロセッサのピン及び、パッケージ間の接合用に用いる2種類超の元素で構成されるはんだに含まれる鉛で、その含有量が80wt%超且つ、85wt%未満のもの 但し、2011年1月1日より前に上市された製品のスペアパーツに限る					
・集積回路パッケージ（flipチップ）の内部半導体ダイ及び、キャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛 ただし、以下のクライテリアの少なくとも一つは該当すること -90nm以上の半導体テクノロジーノード -300mm ² 以上の単一ダイを有する半導体テクノロジーノード -300mm ² 以上のダイもしくは300mm ² 以上のシリコンインターポーザーを有するスタック型ダイパッケージ					

※2. 米国カリフォルニア州 Proposition65 による。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期	
12	水銀及びその化合物	禁止	・包装材	表-3	即時	
			・電池、蓄電池	5ppm [※3]		
			・顔料、塗料、インキ、プラスチックへの調剤 ・水銀を接点としたリレー、スイッチ、センサー	1000ppm		
		除外	一般照明用途のダブルキャップ式の直管蛍光灯中の水銀	3波長形蛍光灯を使用した標準寿命且つ、ランプ径 9mm 未満（例：T2）	4mg	—
				3波長形蛍光灯を使用した標準寿命且つ、ランプ径 9mm 以上 17mm 以下（例：T5）	3mg	
				3波長形蛍光灯を使用した標準寿命且つ、ランプ径 17mm 超 28mm 以下（例：T8）	3.5mg	
				3波長形蛍光灯を使用した標準寿命のランプ径 28mm 超（例：T12）	3.5mg	
				3波長形蛍光灯を使用した長寿命（25000 時間以上）のランプ	5mg	
			特殊用途の冷陰極蛍光灯及び、外部電極蛍光灯（CCFL）及び、EEFL に含まれる水銀	短尺ランプ（500mm 以下）	3.5mg	
				中尺ランプ（500mm 超 1500mm 以下）	5mg	
長尺ランプ（1500mm 超）	13mg					
・プロジェクターの光源として用いられる高圧水銀ランプ	—					
13	パーフルオロオクタンスルホン酸及びその塩（PFOS）	禁止	・織物、コーティングされた材料	1µg/m ² または 1000ppm	即時	
			・アーティクル（上記以外）	1000ppm		
14	特定アミンを形成する一部のアゾ染料・顔料	禁止	・人の皮膚（または口腔）に直接かつ長時間接触する可能性のある織物製品および皮革製品・部品 [※4]	30ppm	即時	
			除外	・上記以外の用途		—
15	三置換有機スズ化合物	禁止	・防腐剤、かび防止剤、塗料、顔料、防汚顔料、冷媒、発泡剤、消火剤、洗浄剤、安定剤、酸化・老化防止剤、防菌・防カビ剤、防汚剤	1000ppm [※5]	即時	
16	ジブチルスズ化合物	禁止	・塩化ビニル樹脂用安定剤、滑剤、触媒	1000ppm [※5]	即時	
17	ジオクチルスズ化合物	禁止	・2成分室温加硫物キット（RTV-2 mouldingkits） ・皮膚と接触することを意図された織物のアーティクルの2つの用途	1000ppm [※5]	即時	
		除外	・上記2つ以外の用途	—		
18	ジメチルホルムアミド（DMF）	禁止	・革製品の防腐剤 ・乾燥剤（シリカゲルパック）	0.1ppm	即時	

※3. 電池に含まれる水銀の閾値に関しては、欧州電池指令の定義と同様に、電池の総質量に占める水銀の質量（つまり電池一本あたりの濃度）にて算出する。

※4. 図面や仕様書で指示したもののみ対象とする。

※5. 金属換算したスズ質量による濃度とする。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
19	多環芳香族炭化水素 (PAHs)	禁止	・人の皮膚または口腔内に直接ならびに長時間または短期間繰り返し接触するゴムまたはプラスチック構成部品 [※6]	1ppm	即時
		除外	・上記以外の用途	—	—
20	パーフルオロオクタン酸 (PFOA) 関連物質 1：ノルウェー法で規制されている8物質 [※7]	禁止	・織物、コーティングされた材料	1µg/m ³	即時
			・アーティクル（上記以外）	1000ppm	
	パーフルオロオクタン酸 (PFOA) 関連物質 2：EU POPs 規則で規制されている物質 [※7]	禁止	・アーティクル（下記以外）	PFOA およびその塩： 25ppb、 関連物質の1つまたは組合せ： 1000ppb [※8]	2020/5/1から
		除外 [※9]	・6原子以下のペルフルオロ炭素鎖を有するフルオロケミカルの製造に対して、輸送される単離中間体として使用される物質（ただし PFOA 関連化合物として 20ppm 以下で存在する場合）	—	—
			・下記用途での使用を目的として製造されるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)及びポリビニリデンフルオライド(PVDF)（2023年1月4日まで） －高性能、耐食性ガスフィルター膜、浄水フィルター膜及び医療用繊維用の膜 －産業用廃熱交換機器 －揮発性有機化合物及びPM2.5微粒子の漏れ防止が可能な産業用封止剤	—	—
			・フトリソグラフィまたはエッチング工程での使用により製造された半導体（2025年1月4日まで）	—	—
			・フィルム用の写真コーティングが施された成形品（2025年1月4日まで）	—	—
			・侵襲性及び移植用医療機器（2025年1月4日まで）	—	—
			・侵襲性及び移植用以外の医療機器（ただし2ppm以下の濃度で存在する場合）	—	—
			・電離放射線または熱分解によって生産されるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)微粉末、ならびに PTFE 微粉末を含有する産業用途および職業用途の混合物およびアーティクル（ただし1ppm以下で存在する場合）	—	—
・医薬品の製造のために使用されるパーフルオロオクチルヨウ化物を含有するパーフルオロオクチル臭化物	—		—		
21	ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD)	禁止	難燃剤	100ppm	即時
22	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)	禁止	可塑剤など	1000ppm [※10]	即時
23	ブチルベンジルフタレート (BBP)	禁止	可塑剤など	1000ppm [※10]	即時
24	ジブチルフタレート (DBP)	禁止	可塑剤など	1000ppm [※10]	即時
25	ジイソブチルフタレート (DIBP)	禁止	可塑剤など	1000ppm [※10]	即時

※6. 該当部品の仕入先様には、リコグループから個別に連絡する。

※7. 対象物質の詳細は表 10 参照。

※8. 成形品中の閾値とする。

※9. 除外に該当する場合にもノルウェー法で規制されている8物質はノルウェー法の基準を満たさなければならない。

※10. EU RoHS 指令対象外製品（包装材、販促品など）の場合は、可塑化された材料中で DEHP, BBP, DBP, DIBP の合計としての閾値とする。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
26	ハロゲンを構造内に含むポリマー及びハロゲン化合物を添加したポリマー	禁止	包装プラスチック部品	—	即時
		除外	包装以外の用途で使用されるプラスチック部品	—	—
27	ペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCAs)、その塩及び関連物質	禁止	アーティクル（下記以外）	C9-C14 PFCAs 及びその塩の合計で 25ppb C9-C14 PFCA 関連物質の合計で 260ppb	2022/8/25 から
		除外	<ul style="list-style-type: none"> ・6 原子以下のペルフルオロ炭素鎖を持つフルオロケミカルの製造に対して、輸送される単離中間体として使用される物質（ただし PFOA 関連化合物として 10ppm 未満で存在する場合） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・下記用途での使用を目的として製造されるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)及びポリビニリデンフルオライド(PVDF)（2023 年 1 月 3 日まで） －高性能、耐食性ガスフィルター膜、浄水フィルター膜及び医療用繊維用の膜 －産業用廃熱交換機器 －揮発性有機化合物及び PM2.5 微粒子の漏れ防止が可能な産業用封止剤 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・フトリソグラフィー又はエッチング工程での使用により製造された半導体（2025 年 1 月 4 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・フィルム用の写真コーティングが施された成形品（2025 年 1 月 4 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・侵襲性及び移植用医療機器（2025 年 1 月 4 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・加圧された定量吸入器(pressurised metered-dose inhalers)のための缶用塗装（2028 年 2 月 25 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・半導体それ自身（2023 年 6 月 30 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・半製品及び完成品の電子機器に組み込まれた半導体（2023 年 6 月 30 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・2023 年 12 月 31 日前に上市された完成品の電子機器のためのスペアパーツ又は予備品のパーツに使用された半導体（2030 年 6 月 30 日まで） 	—	—
			<ul style="list-style-type: none"> ・C9-C14 PFCAs を構成成分とする物質、混合物としてペルフルオロアルコキシル基を含有するフルオロプラスチック及びフルオロエラストマー（ただし 2024 年 2 月 24 日までは C9-C14 PFCAs の合計で 2000ppb 未満で存在する場合、2024 年 2 月 25 日からは C9-C14 PFCAs の合計で 100ppb 未満で存在する場合） 	—	—
<ul style="list-style-type: none"> ・電離放射線または熱分解によって生産されるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)微粉末、ならびに PTFE 微粉末を含有する産業用途及び職業用途の混合物及びアーティクル（ただし C9-C14 PFCAs の合計で 1000 ppb 未満で存在する場合） 	—	—			
28	リン酸トリス(イソプロピルエニル) [PIP(3:1)]	禁止	新規採用する部品・材料	—	2022/4/1 から
		除外	2022 年 3 月 31 日以前から納入されている既存の部品・材料	—	—

2022 年 3 月版

・リコーイメージング株式会社独自の物質リストになります。